

# 苏州赛尔

## 科技有限公司

专业提供半导体IC行业，LED行业，Ipad及车载智能显示屏行业，新能源光伏玻璃行业，高端汽车玻璃加工行业和触摸屏行业等磨、划、切等解决方案。

### 公司主营

- 超薄金属刀片
- 树脂刀片
- 镍基金刚石切割刀片
- 硅片蓝宝石减薄砂轮等



## BGA系列划片刀

### BGA Series Dicing Blades

#### 产品特色

有良好的切割能力和抗变形能力，能够有效减少切割刀片倾斜切割的不良现象。

#### 切割材料

适用于PCB基板、陶瓷基板和BGA等材料的加工。

#### 加工材料

刀片主要针对PCB、BGA，陶瓷基板、及硅晶圆等材料的切割与划片。

#### 产品特性

- 适用于从脆硬材料到半导体基板的各种切割加工；
- 采用高强度结合剂，高品质加工用电铸切割到刀片；
- 实现Sic等难切材料的高品质加工；



带轮毂BGA镍基划片刀（硬刀）



无轮毂BGA镍基划片刀（软刀）



# 苏州赛尔科技有限公司

Suzhou Sail Science & Technology Co., Ltd.

## M1A系列超薄金属结合剂割片

MIA Series Metal Bond Dicing Blades

该系列产品具有高耐磨性，最适用于难加工材料的精密加工；切割刀片刚性高，可以抑制斜面切割及蛇形切割等不良加工现象的发生；结合剂种类丰富，可适用于玻璃、陶瓷、BGA、CSP等各种不同材料的切割加工。



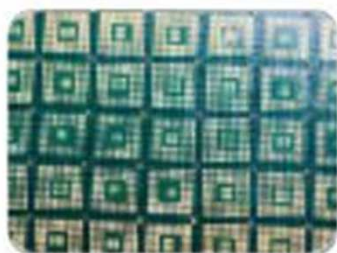
### 产品特性

具有卓越的耐损性与刚性，可实现难切材料的高精密加工  
结合剂品种丰富，可适用于多种工作物的切割加工

### 加工材料

电子元件 光学元件 陶瓷基板 蓝宝石 光学玻璃 石英BGA、CSP封装产品等

### 材料展示



生產製造



銷售代理



# 苏州赛尔科技有限公司

Suzhou Sail Science & Technology Co., Ltd.

## B1A系列树脂结合剂切割片

B1A Series Resin Bond Dicing Blade

树脂划刀片，富有弹性和自锐性，适用于QFN等延展性和粘性材料的高品质切削加工，可有效解决拉丝与毛刺问题，也适用于光学玻璃等硬脆材料高速高品质切削，并有效解决崩边问题。



### 产品特性

可配合加工材料特性，开发满足各种需求的新型结合剂。客户可以根据需求定制不同规格和性能要求的划片刀。赛尔自主开发新型的混料和热压成型技术，保证产品质量稳定。

### 加工材料

QFN、光学玻璃、陶瓷、BGA和砷化镓等

### 材料展示



生產製造



銷售代理



# 苏州赛尔科技有限公司

Suzhou Sail Science & Technology Co., Ltd.

## 减薄砂轮系列

Thinning Grinding Wheels Series

### 加工对象

主要应用于半导体晶圆减薄与精研加工（分立器件、集成电路衬底及原始晶片等）；

### 粒度范围

320#~15000#；

### 应用工序

背面减薄、正面磨削的粗磨加工和精研加工；

### 产品特性

多孔结合剂，具有较高的自锐性；  
进给速度高，大大提高加工效率；  
结合剂配方独特，加工品质优异；  
砂轮磨耗低，使用寿命长；  
可以根据客户要求定制；



陶瓷结合剂硅片减薄砂轮



陶瓷结合剂硅片减薄砂轮



陶瓷结合剂硅片减薄砂轮

### 产品优势

01

结合剂  
纳米级结合剂

02

气孔率  
高气孔率下  
均质组织

03

工艺  
独有的成型  
及烧结工艺



生產製造



銷售代理

## 镍基划片刀系列

### Nickel Hub Blade

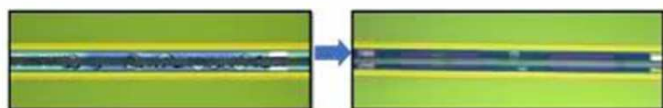
采用超细金刚石微粉电铸到铝合金法兰上形成一体化结构，具有非常高的产品精度，在半导体芯片切割加工过程中，不但具有较高的加工效率，而且还保证了稳定的加工品质。

### 加工材料

砷化镓、氧化物晶圆(钽酸锂、铌酸锂)、及硅晶圆的切割、划片。

### 应用案例

具有非常优良的金刚石镀层效果



## 主营产品分类



S200通用型镍基划片刀系列



S300高端型镍基划片刀系列



S30Z精密型镍基划片刀系列

- 可进行高难度的倒角切割和阶梯切割加工；
- 多种金刚石粒度和结合剂硬度组合，可以满足不同产品的加工要求；
- 产品精度高，大大缩短磨刀时间；
- 特殊制作工艺，极大的避免了刀片破损等问题；